

CLAYTEC HFA dünn 09.009

D 8 mm

- Ökologische Holzfaserausbauplatte (HFA)
- Lehmputz-Trägerlage im Holzbau
- Dünn und preisgünstig



Dünne Holzfaserausbauplatte (HFA) als Putzträger auf Holz- und Holzwerkstoffen. Die Platten können geschraubt oder geklammert werden. So entsteht auf Holz sehr einfach ein sicherer Untergrund für die Armierungslage aus Lehmklebe- und Armierungsmörtel und das nachfolgende Lehm-Finish.

CLAYTEC HFA dünn

09.009

Anwendungsgebiet Holzfaserbauplatte (HFA) als Putzträger im Holzbau für CLAYTEC Lehmputze.

Baustoffwerte Rohdichte 230 kg/m³, Druckfestigkeit ≥ 100 kPa, Wärmeleitfähigkeit-Wert 0,05 W/mK, μ 5, Spez. Wärmekapazität 2.100 J/kgK, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: E

Maße 1,20 m x 0,60 m = 0,72 m². D = 8 mm.

Lieferform 276 Platten/EW-Pal.

Lagerung Liegend auf Paletten, plan und trocken lagern. Kanten vor Beschädigungen schützen

Materialbedarf Bei der Ermittlung des Materialbedarfs Reserve von ca. 10% für Verschnitt etc. berücksichtigen.

Untergrund Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, trocken, sauber (Holzwerkstoffplatten staubfrei), frei von Salzbelastung, ausreichend rau und saugfähig sein. Fehlstellen grob ausbessern. Sandene Untergründe ggf. mit CLAYTEC Tiefengrund und Festiger fixieren.

Verarbeitung Feuchtebeanspruchungen aus nass eingebauten Putzen und Estrichen sind nicht zulässig, allgemein darf die rel. Luftfeuchte bei Lagerung und nach dem Einbau 70% nicht übersteigen. Der Feuchteintrag durch Verklebung oder Verputz ist so niedrig wie möglich zu halten.

Die Platten werden mit der Stichsäge, der Kreissäge oder mit dem Cuttermesser geschnitten.

Die unterste Plattereihe wird mit etwas Abstand („Luft“) zum Boden eingebaut.

Die Platten werden ohne Klebung mit CLAYTEC Lehmbauplattenschrauben 5 x 50 mm, WÜRTH Schnellbauschrauben mit Grobgewinde oder KNAUF Universalschrauben FN befestigt, Schraubenstand ca. 20 cm, bei nachfolgender Dicklagenbeschichtung enger. Als Klammern sind z. B. BEHRENS (BEA) 155/18_NK_HZ, Art.-Nr. 10002009, oder artgleich geeignet. Klammerabstand ca. 9 cm, Randabstand 10-15 mm.

Im Bad sind immer rostfreie Befestigungsmittel zu verwenden.

Die Fortführung von Wandöffnungsbegrenzungen durch horizontale oder vertikale Fugen ist unzulässig. Die Verarbeitung der Platten erfolgt mit um mind. 20 cm, besser 30 cm versetzten Stößen.

In Bädern nur korrosionsfreie Befestigungsmittel verwenden.

Weiterbehandlung Spalte ≥ 1 mm Breite ggf. mit CLAYTEC Lehmklebe- und Armierungsmörtel oder Lehm-Oberputz fein 06 ausspachteln und trocknen lassen. Platten sorgfältig entstauben.

Dünnlagenbeschichtung: Die Flächen werden 3 mm dick mit Lehmklebe- und Armierungsmörtel überzogen. Er kann auch mit der Putzmaschine angespritzt werden, Ruhezeiten sind bei dieser Anwendung nicht notwendig. In die noch nasse Oberfläche wird Glas- oder Flachsgewebe flächig eingearbeitet. Nach Trocknung YOSIMA Lehm-Designputz fachgerecht auftragen. Für das YOSIMA Lehm-Farbspachtelsystem oder das CLAYFIX Lehm-Anstrichsystem Armierungslage sehr sorgfältig ausführen (= Schraublöcher und Vertiefungen vorab schließen und Stellen trocknen lassen), besser dünn mit Lehm-Oberputz fein 06 verputzen.

Dicklagenbeschichtung: Die Flächen werden mit der Grundierung DIE ROTE vorbehandelt. Lehm-Unterputz Stroh, Lehmputz Mineral oder SanReMo in einer Lagendicke max. 8 mm auf Wandflächen und max. 5 mm auf Decken- oder Dachschrägenflächen auftragen. In die noch nasse Oberfläche wird Glas- oder Flachsgewebe flächig eingearbeitet. Trocknen lassen. Gesamtputzaufbaudicke Wand max. 15 mm, Decken- oder Dachschrägen max. 10 mm (jeweils mind. zweilagig).

Wandflächenheizung: Vorbereiten der Flächen mit der Grundierung DIE ROTE oder mit Zahnpachtelung aus Lehmklebe- und Armierungsmörtel. Trocknen lassen. Vorspritz bis max. 8 mm mit einem der o.g. Lehmputzmörtel. Nach Trocknung Auffüttern bis Rohrscheitel Wandheizung. Trocknung des gesamten Unterputzes mit Heizungsunterstützung. Weiteres siehe CLAYTEC Arbeitsblatt Lehmputze.